

证券代码：688401

证券简称：路维光电

转债代码：118056

转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-011

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场调研 ☐ 其他 ☒ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 电话会议
---------------	---

	海古曲私募基金管理有限公司、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司、高腾海外私募基金管理（海南）有限公司、深圳展博投资管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、福州天朗私募基金管理有限公司、天津华璞资产管理有限公司、深圳智富圈基金、万丰友方、上海云门投资管理有限公司、彬元资本
调研时间	2025 年 10 月 31 日
会议地点	公司会议室、进门财经
上市公司接待人员姓名	董事、财务总监：刘鹏先生 投资者关系：刘文鑫女士
投资者关系活动内容记录	1、公司简单介绍 2025 年三季度业绩情况？ 2025 年前三季度，路维光电实现营业收入 8.27 亿元，同比增长 37.25%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元，同比增长 41.88%；2025 年第三季度，公司实现营业收入 2.83 亿元，同比增长 36.80%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.65 亿元，同比增长 69.08%。根据下游行业划分产品，2025 年前三季度公司平板显示掩膜版与半导体掩膜版均实现了良好的增长态势。 从盈利能力来看，2025 年第三季度路维光电毛利率为 36.40%，同比提升 1.30%；净利率 23.09%，同比提升 4.41%。未来随着公司产品结构持续优化和费用管理持续精益化将带来公司盈利能力提升。 2、公司目前在平板显示掩膜版领域的地位与进展？ 在平板显示掩膜版领域，公司是国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线（G2.5-G11）的本土掩膜版企业，实现全显示技术覆盖（LCD、AMOLED、LTPS、LTPO、Mini-LED、Micro-LED、硅基 OLED、FMM 用掩膜版等）。公司产品技术领先，多次打破海外垄断。（1）在 G11 高精度超大尺寸掩膜版领域，公司于 2019 年成功建设国内首条 G11 高世代掩膜版产线并投产，成为国内首家且唯一一家、世界第四家掌握 G11 掩膜版生产制造技术的企业。根据 Omdia 数据，2024 年公司 G11 掩膜版销售收入市场占有率为 25.52%，位列全球第二名。（2）在半色调掩膜版领域，公司于 2018 年成功实现 G2.5 等中小尺

寸半色调掩膜版投产，并于 2019 年先后研发并投产 G8.5、G11 TFT-LCD 半色调掩膜版，2024 年量产 AMOLED 用 HTM 掩膜版产品，HTM 产品目前可以覆盖全世代，打破国外厂商长期技术垄断；（3）在 PSM 领域，公司于 2021 年完成衰减型相移掩膜版(ATT PSM)工艺技术研发并通过内部测试，2023 年量产 Metal Mesh 用 PSM 掩膜版，CF 用 PSM 产品于 2024 年通过客户验证并量产，TFT-Array 用 PSM 掩膜版产品已打通关键环节，计划于 2025 年进行试样验证；AMOLED PSM 用掩膜版产品正在推进前期预研，根据客户技术迭代与市场需求，逐步推进量产；2024 年完成研发单层衰减型 PSM 掩膜版制造技术及 Mosi 系双层 PSM 掩膜版制造技术研发，可应用于 G6 及以下平板显示掩膜版以及半导体掩膜版。（4）在光阻涂布领域，公司分别于 2016 年、2018 年自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术，实现了国内掩膜版行业在高精度、大尺寸光阻涂布技术上零的突破及对产业链上游技术的成功延伸。

为进一步扩充公司高世代高精度掩膜版的产能，公司于厦门市投资建设“厦门路维光电高世代高精度光掩膜版生产基地项目”。该项目总投资额为人民币 20 亿元，计划建设 11 条高端光掩膜版产线，重点研发生产 G8.6 及以下 AMOLED/LTPO/LTPS/FMM 用高精度光掩膜版，项目已于 2025 年 7 月完成奠基仪式。项目分阶段实施，其中一期将建设 5 条 G8.6 及以下 AMOLED 高精度掩膜版产线，配置 5 台（套）核心主设备及 22 台（套）精密辅助设备。目前，一期项目设备已开始有序采购，预计 2026 年设备将陆续到厂并进行安装调试，2026 年下半年实现收入。项目投产后，公司产能将显著提升，能够更充分地满足下游客户需求，助力公司持续提升在客户供应链中的份额，加速推进国产化替代进程，进一步推动平板显示掩膜版国产化率提升。

3、公司目前在半导体掩膜版领域的地位与进展？

在半导体掩膜版领域，目前公司已实现 180nm 制程节点半导体掩膜版量产，150nm/130nm 制程节点半导体掩膜版已经通过客户验证并小批量量产，满足集成电路芯片制造、先进半导体芯片封装和器件等

	应用需求。 在先进封装领域，公司是国内先进封装掩膜版的龙头供应商，结合传统小尺寸 IC 掩膜版高精细特性与大尺寸显示掩膜版的丰富生产经验，可以满足国内各类新型先进封装的技术要求，包括但不限于 CoWoS、CoWoP、CoPoS、FOPLP 等。这些新型先进封装都对封装掩膜版提出了更严苛的技术要求，如更小的线路图形、更大的掩膜尺寸面积、更高的套刻精度、更均匀的 CD 精度等。公司已是华天科技（先进封装）、通富微电（先进封装）、奥特斯（高端载板）、鹏鼎控股（高端 PCB 板厂）等国内多个头部封装、载板、PCB 板厂的主要供应商。 公司投资建设的路芯半导体掩膜版项目进展顺利，制程节点布局居于国内厂商前列。项目一期覆盖 130-40nm 制程节点半导体掩膜版。报告期内，一期项目的电子束光刻机等主要设备已陆续到厂并有序投入生产，90nm 及以上半导体掩膜版已向客户陆续送样并获部分客户验证通过，2025 年下半年启动 40nm 半导体掩膜版试生产工作。未来伴随项目的顺利投产，公司产品将陆续覆盖 MCU（微控制芯片），SiPh（硅光子）、CIS（互补金属氧化物半导体图像传感器），BCD（双极-互补-双扩散-金属氧化物半场效应管），DDIC（显示驱动芯片），MS/RF（混合射频信号），Embd. NVM（嵌入式非易失存储器），NOR/NAND Flash（非易失闪存）等半导体制造相关行业，进一步完善产业链供给、推动国产替代进程。 4、影响掩膜版需求的主要是哪些因素？ 掩膜版的需求主要来自于下游产品的更新迭代、新技术的迭代应用、新场景的开拓应用，与终端产品的多样性紧密相关，并非与下游的量价变动趋势有直接的线性关系。因此掩膜版受下游行业周期性影响较小，这与其他易受周期影响的半导体材料发展逻辑有所差异。 具体而言，下游面板厂商建设新的产线、工厂和增加曝光设备，开拓新客户、开发新面板、增加曝光次数、工艺增强都需要新的掩膜版才能够保证产线的顺利运行。当前显示技术呈现多样化的格局，一
--	---

	种面板采用不同的驱动技术（如 a-Si、LTPS、IGZO、LTPO 等，像 LTPO 又分 1 代、2 代、3 代），采用不同的生产工艺（如蒸镀、ViP、印刷等），使得每套掩膜版的总层数也会不同。面板厂增加新品种、新技术的研发过程中，会产生更多的开模需求，即便部分开发样板虽然最终不会转化成成品进行销售，但是同样也需要配套的掩膜版。面板厂工艺改进以及掩膜版在使用过程中出现的损耗都会增加额外的掩膜版需求。同一类别的面板，因其定制化的特性，当需要在不同的产线生产或者不同厂商生产时，都需要重新配套掩膜版。而同样尺寸和分辨率的面板，如果刷新率、像素设计、驱动设计等方面发生变化或更新，也需要新的掩膜版。 伴随半导体制程节点向前推进、显示技术从 LCD 向 OLED 切换、LTPS 向 LTPO 切换，下游行业对掩膜版的需求层数、单片精度都在不断提升；下游 AI 芯片、汽车电子等应用场景不断扩展催生更多技术种类，推动掩膜版需求增长；封装技术革新进一步催生先进封装掩膜版需求高增，例如 Chiplet、3DIC、FOPLP 等先进封装技术发展带动 RDL/TSV/TGV 等工艺用掩膜版需求提升；显示技术迭代（例如 8K、折叠屏、透明 OLED、双栈串联、COE 等）也为掩膜版市场注入新动能。掩膜版的需求增长不仅是“量”的增加，更是“质”的升级（精度、尺寸、材料适配性）；下游显示行业、半导体行业本土化趋势正在持续拉动本土掩膜版的需求增长。下游应用的多元化（从传统芯片到 AI、汽车、AR）和技术演进（EUV、Chiplet、Micro-LED）共同推动行业进入高景气周期。 5、公司后续景气度展望？ 伴随下游行业更新迭代带来的需求繁荣，公司扩产与客户拓展有条不紊地开展，未来有望增厚公司整体业绩。公司近两年加快了投资节奏，每年扩产稳步进行，目标是成为世界级的掩膜版企业，为半导体、显示产业链全面自主贡献自己的产业力量，为全体股东创造更大的价值！
关于本次活	本次活动不涉及应当披露重大信息。

动是否涉及 应当披露重 大信息的说 明	
风险提示	以上内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不视 作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资 者注意投资风险。
附件清单	无